

令和元年6月27日

関係各位

日本実装技術振興協会
高密度実装技術部会
部会長 嶋田 勇三

第197回高密度実装技術部会 定例会のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のことお慶び申し上げます。
さて、高密度実装技術部会の第197回定例会の内容が決まりましたのでお知らせいたします。
多忙の中恐縮でございますが、万障お繰り合わせの上、ご出席下さいますようお願い申し上げます。

Facebook

(<https://www.facebook.com/%E9%AB%98%E5%AF%86%E5%BA%A6%E5%AE%9F%E8%A3%85%E6%8A%80%E8%A1%93%E9%83%A8%E4%BC%9A-938695649492729/>)でも同定例会の情報を配信しております。

敬具

記

1. 開催日時: 令和元年7月18日(木) 定例会 12:40~17:20(受付 12:25~)
技術交流会 17:30~19:00

2. 開催場所: 川崎市産業振興会館1階ホール
川崎市幸区堀川町66-20
<https://www.kawasaki-net.ne.jp/kaikan/access.html>
JR線「川崎駅」・京急線「京急川崎駅」下車 徒歩8分

3. プログラム: “未来社会を支える最先端ディスプレイと画像認証・照合技術”

12:40~13:30	『最先端映像技術－顔認証の技術と応用事例』 日本電気(株) バイオメトリクス研究所 主任研究員 大網 亮磨 氏 講演内容: 顔認証技術は、積極的に認証動作をしなくても認証できる、後からでも画像から容易に本人特定可能といった、他の生体認証技術にはない優位性がある。米国国立標準技術研究所(NIST)が定期的に評価テストを実施し、技術の大きな進展が図られ、日常の様々な場面で導入が進んでいる。本講演では、顔認証アルゴリズムの変遷やその応用事例について紹介する。また、関連技術として見ている方向を推定する視線推定技術や人物全体で認証する人物照合技術についても紹介する。
13:30~14:20	『高輝度LEDのパッケージングテクノロジーとUVLED及びマイクロLEDの技術動向』 Green Planets(株) 代表取締役社長 奥野 敦史 氏 講演内容: VPESによるLED Packagingの技術と高輝度LED、UVLEDおよび最近注目されているmicroLEDの技術について紹介する。
14:20~15:10	『フレキシブル有機ELの課題と、当研究室の取組み ～水分侵入を防ぐ安価なパネル構造の研究～』 山形大学 有機エレクトロニクスイノベーションセンター 准教授 硯里 善幸 氏 講演内容: 有機ELは透明化・フレキシブル化が可能であることから、スマートフォン・TVのディスプレイだけでなく、車載等の広い分野で注目されている。有機ELは水分により非発光領域が進行することがフレキシブル化における最大の課題である。本講演ではフレキシブル化の課題を説明するとともに、新しい取り組みである塗布型封止構造やガラスをベースとした湾曲パネルに関しても紹介する。
15:10~15:25	－ 休憩 －

15:25～16:15	<p>『量子ドット蛍光体材料の開発とディスプレイへの応用 ーカドミウムフリー化への取り組みと発光素子開発の動向ー』 東北大学 多元物質科学研究所 助教 佃 諭志氏</p> <p>講演内容: 半導体量子ドット蛍光体は量子サイズ効果を利用して発光波長を任意に制御でき、かつ単色性の高い発光スペクトルを実現できる。CdSe 量子ドットを搭載したディスプレイが既に市販されているが、Cd は高い毒性を有するため、より安全な非 Cd 系量子ドット蛍光体の開発が急務となっている。本講演では、現在のカドミウムフリー量子ドットの開発状況、及び発光素子開発の最新の動向について紹介する。</p>
16:15～17:15	<p>『フラットパネルディスプレイ業界の見通し』 みずほ証券(株) エクイティ調査部 グローバル・ヘッド・オブ・テクノロジー・リサーチ/シニア・アナリスト 中根 康夫 氏</p> <p>講演内容: PC、テレビ、スマートフォンといった主要アプリケーション市場が成熟化し、フラットパネルディスプレイへの需要も数量成長への期待ができず、面積(大型化)と高付加価値化(タッチパネルなど各種機能の取り込み)が鍵となっている。そのなかで LCD から OLED への移行という傾向が明確になりつつある。今後のフラットパネルディスプレイ業界の見通しを、完成品需要、完成品ブランド、パネルメーカ、地域軸、バリューチェーン、技術軸など様々な観点から分析し、議論していく。</p>
17:30～19:00	<p>- 技術交流会 -</p>

以上

6. 参加費: **会員は3名まで無料** (この場合は**高密度実装技術部会の会員**が対象になります。)
会員外の参加は、¥22,000/人(当日会場にて徴収、領収書をご用意いたします。)

追記: ご出欠については同送致しましたご出欠連絡用紙にて、E-mailもしくはFAXにて**令和元年7月11日(木)迄**にご連絡をお願いします。またご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さいませようお願い致します。

事務局: 日本実装技術振興協会 担当/相良(サガラ)・太田
 〒335-0021 埼玉県戸田市新曽 45 「高密度実装技術部会」事務局
 携帯: 090-5403-1147(相良)、090-5301-9467(太田) / FAX 048-443-4204
 E-mail: jjisso.org@gmail.com URL: <http://www.j-jisso.org/index.html>